

深圳市信维通信股份有限公司

关于签署合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本协议所述的拟投资项目“信维通信科技园项目”尚需进一步可行性研究，并拟通过立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉及到的规模、建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。公司将根据项目后续的投资规模及进展，按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。

一、合作协议概况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日与江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园管理委员会（以下简称“金坛管委会”）签订了《合作协议》（以下简称“协议”）。公司拟在金坛华罗庚科技产业园（以下简称“华科技园”）投资建设“信维通信科技园项目”（以下简称“金坛项目”或“项目”），并通过已设立的全资子公司信维通信（江苏）有限公司（以下简称“项目公司”）具体实施该项目。

在协议签订后，公司将进一步对金坛项目进行详细的可行性论证，同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后正式实施。

本次拟进行的合作协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作协议的主要内容

公司在金坛华罗庚科技产业园内设立全资子公司信维通信（江苏）有限公司，注册资本1亿元，主要从事射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无

线通信和物联网的软硬件、自动化生产设备、天线及声学组件、连接器、精密五金件、精密电子产品的研发、制造和销售等业务。2016年9月14日第三届董事会第三次会议已审议通过该全资子公司的设立（详情请见公告号2016-062）。

项目公司拟竞拍位于金坛华罗庚科技产业园的国有土地作为项目用地，土地面积约为400亩（以实际出让的土地面积为准），最终成交金额以挂牌成交价为准。项目计划于2017年9月30日前开工建设。

待项目公司竞得土地使用权后，公司将以公告的形式进一步披露土地具体地理位置及其他相关信息。

三、合作协议的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的和对公司的影响

此项目是公司在深圳、北京以外打造的另一个产业基地，实现国内的多点布局，全方位覆盖及服务客户，拓宽业务销售范围、有效集约整合销售资源，增强公司研发、生产及销售流程的运营管理效率。

此项目将有助于公司更好地利用长三角优秀的行业研发、技术资源和优越的地理位置，更好地为世界一流移动终端客户提供研发、制造服务及技术支持；也有助于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的增长。

2、存在的风险

（1）根据项目后续的投资规模及进展，公司将按照相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议，项目能否获得批准、何时获得批准以及能否顺利实施存在不确定性。

（2）本协议所述的拟投资项目尚未进行立项审批、环境影响评价审批，该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、公司能否最终竞买取得土地均存在不确定性。

四、其他

公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，根据该事项的进展或变化情况履行相关的披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司与金坛华罗庚科技产业园管理委员会签订的《合作协议》。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

2016年9月30日